

JJAP Part 1 特集号への投稿のお誘い

2005 年国際固体素子・材料コンファレンス(SSDM 2005)において発表される論文は、引き続き Japanese Journal of Applied Physics (JJAP) Part 1 の SSDM 2005 特集号 (2006 年 4B 号) に投稿することができます。研究成果を Full Paper としてより広く周知させるためにも、貴論文の特集号への投稿をお勧めします。

御投稿に際しましては、下記投稿に関する注意をお読みにになり、JJAP 投稿規定に沿って投稿下さるようお願いいたします。(招待論文の方については、オリジナルな部分に関しての投稿となります。)

JJAP Part 1 特集号への投稿締切は 9 月 15 日です。

JJAP Part 1 特集号に御投稿される場合のスケジュールは下記のようになります。

9 月 13 日 - 15 日 ● 2005 年国際固体素子・材料コンファレンス (SSDM 2005)

9 月 15 日 ● 特集号への投稿締切 (JJAP 編集部)

2006 年

4 月 30 日 ● 特集号 (4 B 号) 発行

SSDM 2005 発表論文の JJAP Part 1 特集号への投稿に関するご注意とお願い

- ① JJAP Part 1 特集号に投稿する論文は、SSDM 2005 Extended Abstract と全く同一のものではないようにして下さい。内容は、データや記述の追加、より詳細な議論の展開などが含まれた、オリジナルなものを求めます。
- ② 特集号に投稿された論文は、JJAP の通常の閲読手続を経て採否が決定されます。投稿された論文がすべて掲載許可となるわけではありません。
- ③ 特集号へ投稿された論文が、閲読者との討論やそれに基づく修正などにより、閲読後の最終原稿の締切を過ぎた場合は、次号以降掲載の通常論文としての扱いを受けることとなります。
- ④ 招待論文の場合は、その内容のオリジナルな部分について投稿を歓迎します。その場合にも、上記①-③項が適用されます。
- ⑤ 掲載料 (別刷り代) や投稿手続は、JJAP Part 1 の投稿規定に従っていただきます。
- ⑥ 投稿にあたっては下記 URL を必ずご一読ください。

JJAP 特集号に投稿される方へ

http://www.ipap.jp/jjap/authors/Appl_form/jjapform_special_j.pdf

Application Form および Agreement for Copyright Transfer and Payment of Publication Charge に必要事項を記入、署名 (2 箇所) のうえ、

- ・ 論文原稿 1 部
- ・ PDF フォーマットの電子ファイル

(テキスト、図、表等を必ず 1 つのファイルにまとめてください)

とともに下記へ郵送して下さい。

なお、封筒の表には「SSDM 特集号投稿原稿」とお書き添えください。

JJAP Part 1 特集号への投稿締め切り 2005 年 9 月 15 日

原稿送付先

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-22 湯島ビル
物理系学術誌刊行協会 (SSDM 2005 特集号)
TEL:03-5844-3291, FAX:03-5844-3290

SSDM 2005 論文委員長
鳥海 明